

Q2 FY26

鴻海精密工業股份有限公司

第二季法人說明會

Aug. 12, 2026

$3+3+3=\infty$

免責聲明



- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報所揭露財務資訊未完全經會計師查核或核閱，所有資訊僅供參考。詳細內容請參考查核財務報告。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

目錄



- 1. 2026年第二季回顧**
- 2. 2026年全年暨第三季展望**
- 3. 重要事業進展**
- 4. 近期重大事件**
- 5. 問答時間**

本季法說會重點摘要



- 1. 財務表現：**
產品組合與營運規模提升，核心獲利大幅成長。
- 2. 第三季與全年展望：**
季對季顯著成長、年對年強勁成長；全年展望強勁成長。
- 3. 價值延伸：**
完整系統解決方案，延伸至零組件、液冷、MDC、資料中心。
- 4. 長期展望：**
市場需求強勁，將持續擴充全球AI產能因應；明年展望正向。

1 2026年第二季回顧

2026年第二季財務三表



1. 損益表

(新台幣百萬元)

	Q2/26	Q1/26	QoQ	Q2/25	YoY
營業收入	2,525,894	2,119,533	19%	1,793,468	41%
營業毛利	154,533	130,981	18%	113,529	36%
營業利益	94,803	75,649	25%	56,596	68%
營業外收入及支出	63	(1,617)	104%	8,553	-99%
稅前淨利	94,866	74,031	28%	65,149	46%
所得稅費用	(24,810)	(17,075)	45%	(15,613)	59%
本期淨利歸屬母公司業主	59,974	49,919	20%	44,361	35%
基本每股盈餘 (新台幣元)	4.27	3.56	20%	3.19	34%
毛利率	6.12%	6.18%	-6 bps	6.33%	-21 bps
營業利益率	3.75%	3.57%	18 bps	3.16%	60 bps
淨利率	2.37%	2.36%	2 bps	2.47%	-10 bps
ROE	3.41%	2.88%	53 bps	2.85%	56 bps

2026年上半年損益表



損益表

(新台幣百萬元)

	2026H1	2025H1	YoY
營業收入	4,645,428	3,437,784	35%
營業毛利	285,514	214,077	33%
營業利益	170,452	103,096	65%
營業外收入及支出	(1,554)	21,174	-107%
稅前淨利	168,898	124,270	36%
所得稅費用	(41,885)	(28,899)	45%
本期淨利歸屬母公司業主	109,893	86,469	27%
基本每股盈餘 (新台幣元)	7.84	6.23	26%
毛利率	6.15%	6.23%	-8 bps
營業利益率	3.67%	3.00%	67 bps
淨利率	2.37%	2.52%	-15 bps
ROE	6.21%	5.48%	73 bps

2026年第二季財務三表



2. 資產負債表

(新台幣百萬元)

	2026.6.30	2026.3.31	QoQ	2025.6.30	YoY
現金及約當現金	963,002	986,317	-2%	870,520	11%
應收帳款淨額	1,385,237	1,166,008	19%	940,523	47%
存貨	1,370,073	1,209,878	13%	935,827	46%
採用權益法之投資	203,279	198,174	3%	183,219	11%
不動產、廠房及設備	576,855	562,220	3%	458,118	26%
資產總計	5,622,576	5,230,479	7%	4,138,942	36%
應付帳款	1,527,523	1,322,837	15%	1,003,773	52%
應付公司債	294,708	289,268	2%	264,668	11%
負債總計	3,502,989	3,241,681	8%	2,507,335	40%
權益總計	2,119,588	1,988,798	7%	1,631,608	30%
淨現金	219,809	325,091	-32%	243,617	-10%
應收帳款週轉天數	46	51	-4	51	-5
存貨週轉天數	50	53	-3	54	-4
應付帳款週轉天數	54	60	-6	57	-3
現金週轉天數	42	44	-2	48	-6
負債比	62%	62%	-	61%	2%

2026年第二季財務三表



3. 現金流量表

(新台幣百萬元)	2026.1.1~6.30	2025.1.1~6.30
營業活動之淨現金流入 (出)	(69,122)	21,876
投資活動之淨現金流入 (出)	(25,761)	(39,356)
籌資活動之淨現金流入 (出)	15,745	39,477
資本支出	(80,886)	(77,150)
自由現金流 ¹	(150,009)	(55,275)

¹ 自由現金流量 = 營業活動之現金流入 - 資本支出

2026年第二季回顧



2 2026年第三季暨全年展望

2026年第三季展望



QoQ



YoY



2026年全年展望



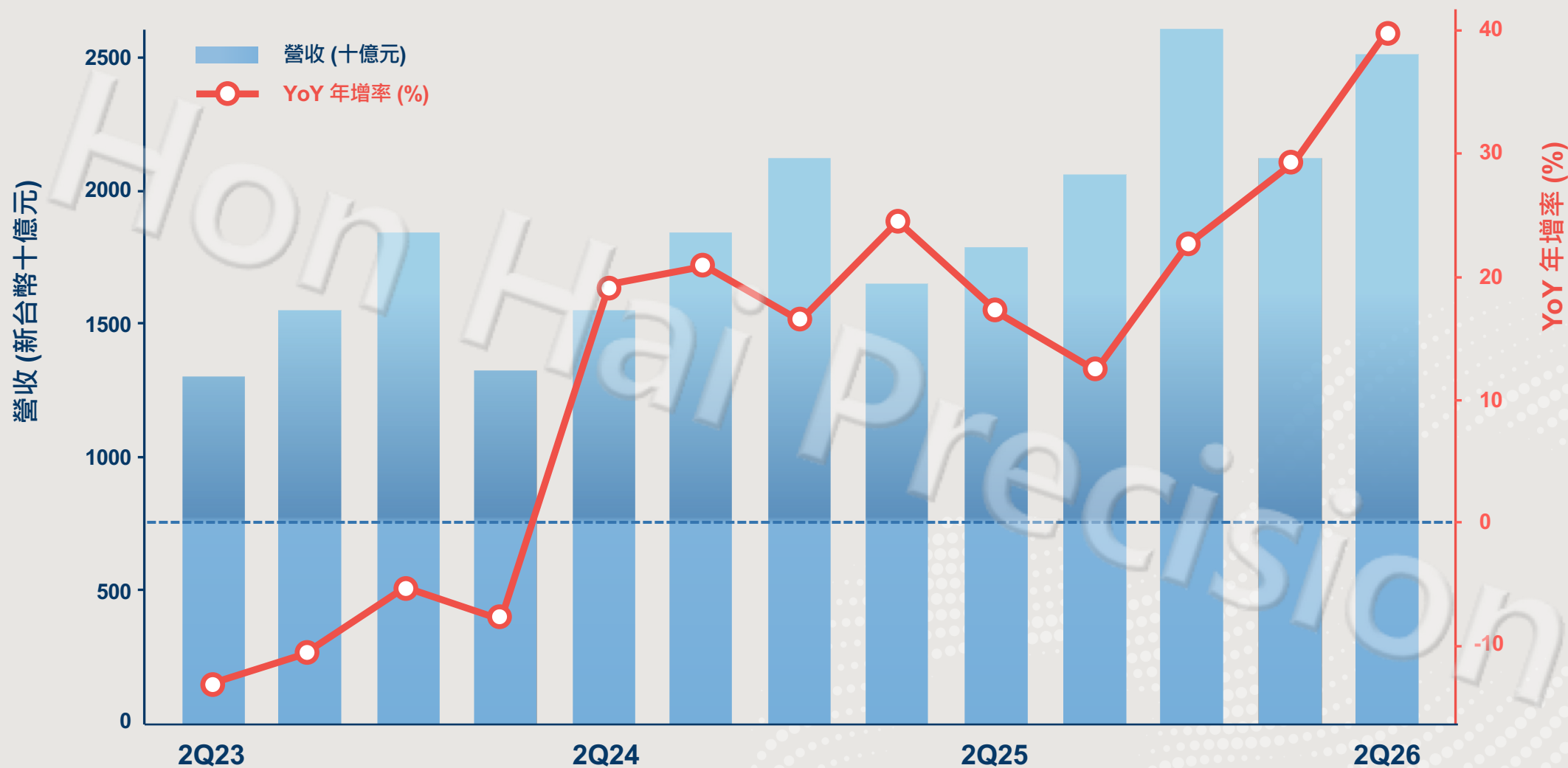
YoY
2026/5/14



YoY
2026/8/12



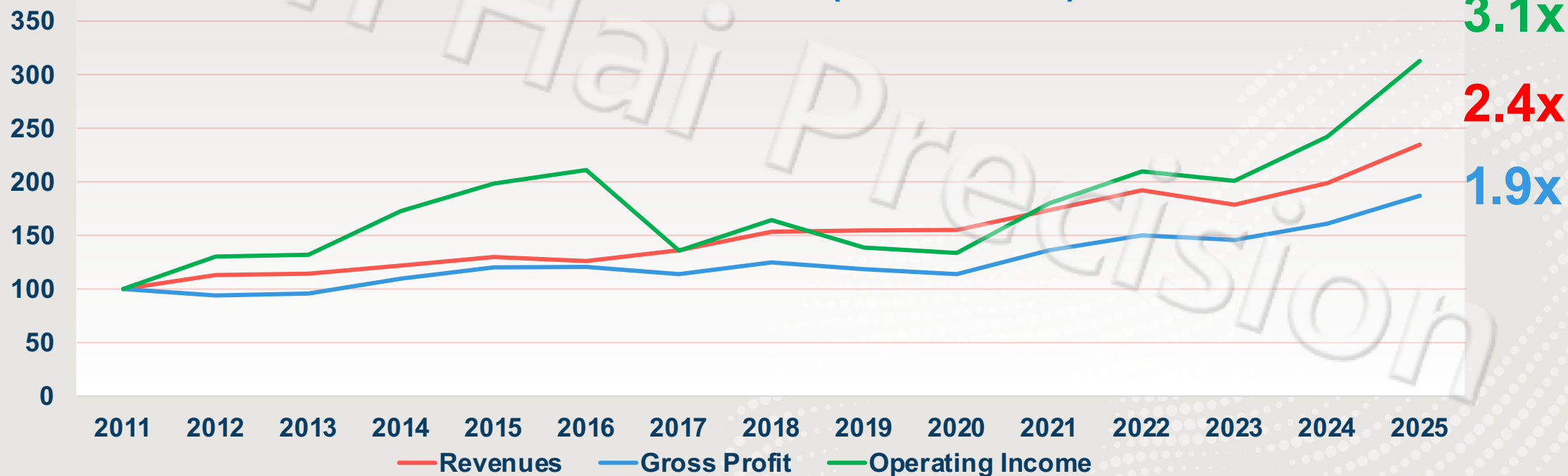
AI基建驅動，成長力道增強



產品組合優化與規模優勢提升長期獲利展望

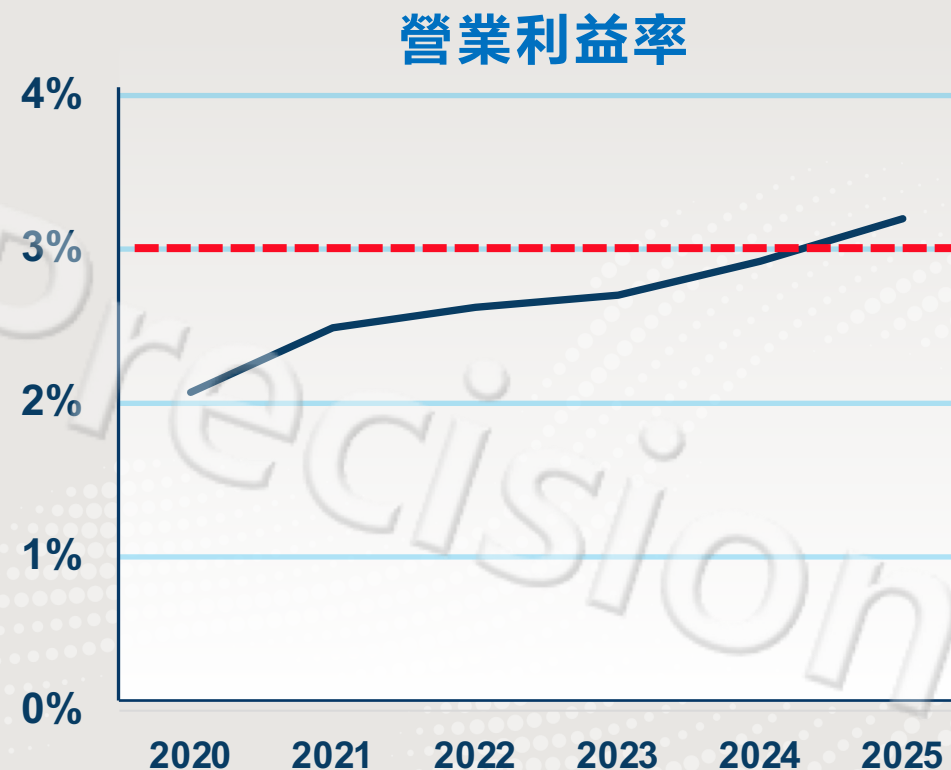
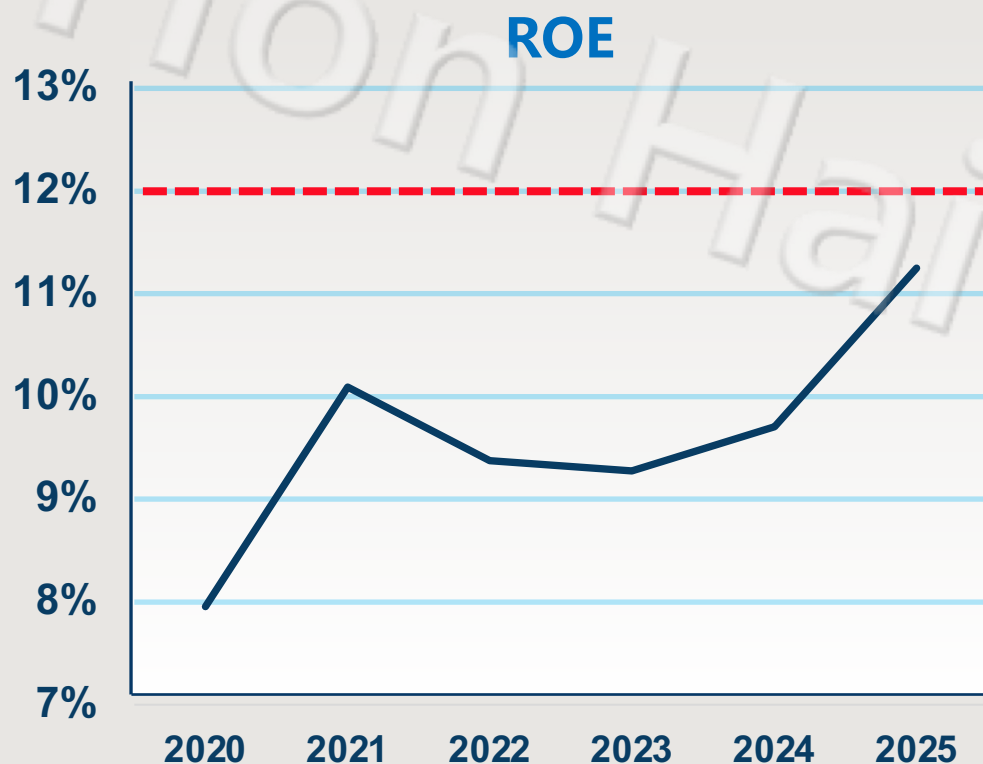
- 毛利成長約 1.9倍，反映核心業務產品優化以及規模穩健擴張
- 營業利益成長逾 3倍，高於營收約 2.4倍的成長幅度
- 上半年營業利益年增 65%，高於營收 35%的成長幅度

2011年以來成長趨勢 (2011年=100)

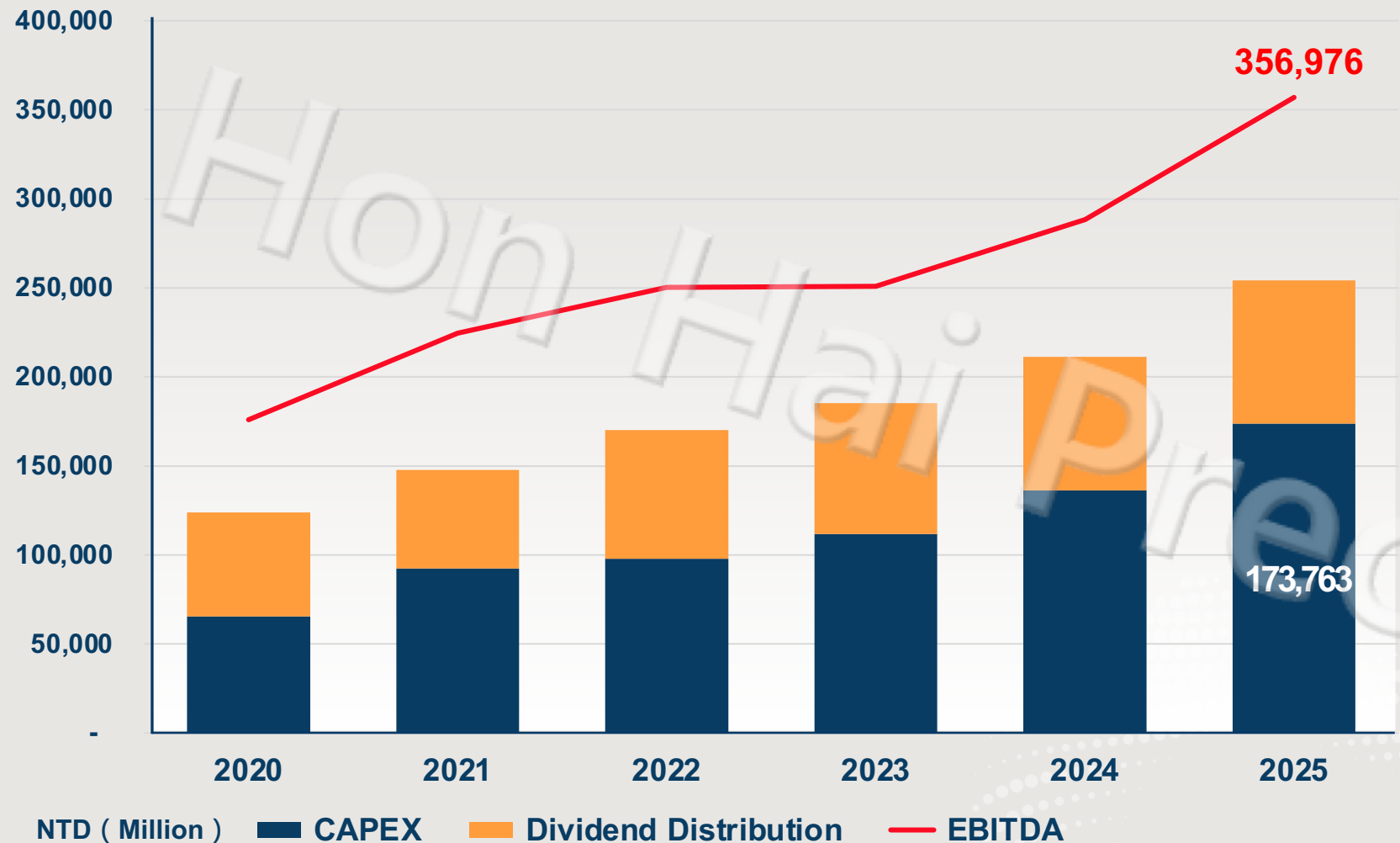


財務亮點：獲利能力持續提升

- 上半年ROE達 6.21%，高於去年同期的 5.48%
- 上半年營業利益率達 3.67%，高於 3% 的目標



EBITDA穩健成長，兼顧資本支出與股利發放



上半年EBITDA及CAPEX



3 重要事業進展

以規模與整合為基石，以研發與自動化驅動價值



研發創新與高階導向



垂直整合與高自動化



全球布局與規模效益



AI需求強勁，0-100 能力策略結盟主要客戶



擴展 AI 基礎設施的關鍵能力

「從 0 開始」

客戶開發



- 客戶關係
- 市場佔有率
- TTM
- TTC
- TTT

「0 到 1」

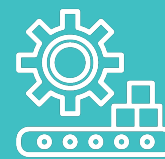
設計與共同開發



- 系統架構
- 參考設計
- 可製造性設計

「1 到 100」

規模化量產製造



- 自動化
- 規模
- 良率
- 全球布局

AI 需求

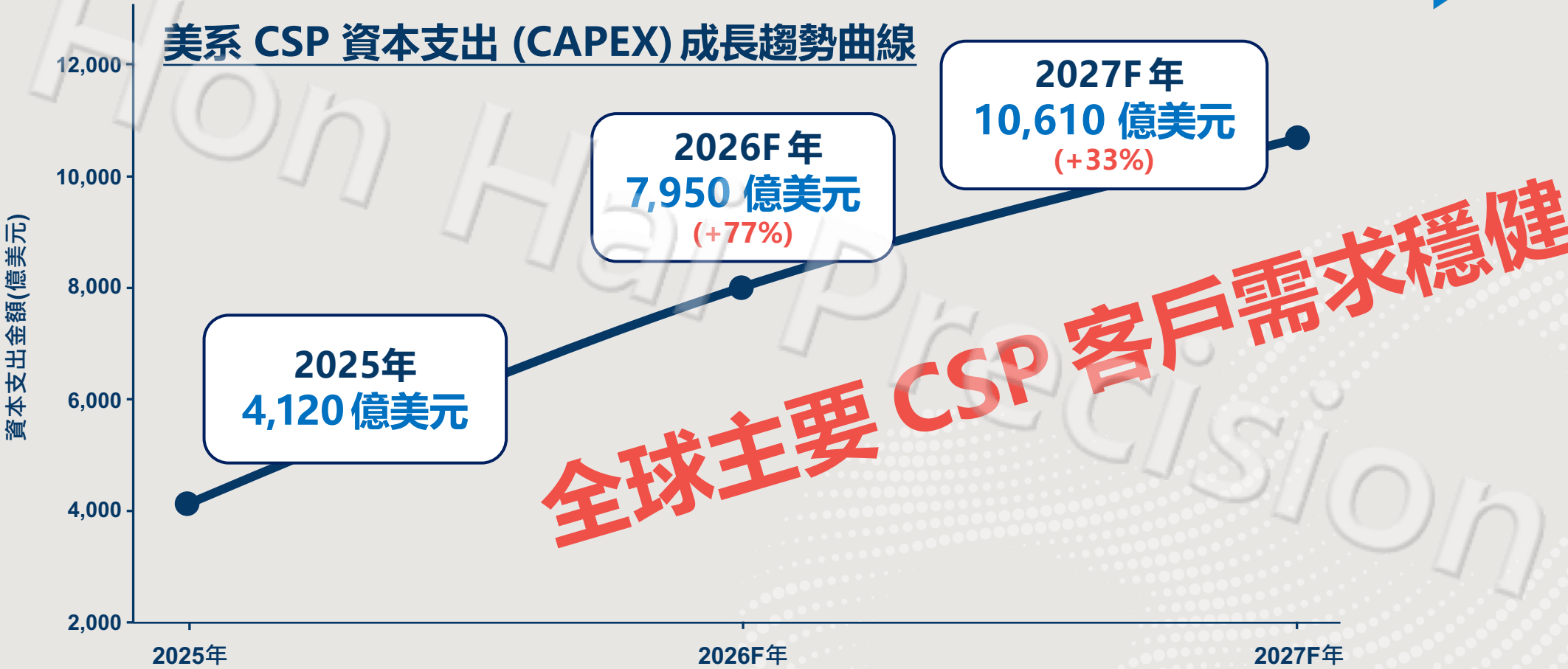
AI 開發商

CSP /
新型雲端服務商

政府

企業客戶

雲端投資持續擴大，以整合能力承接AI需求



AI需求強勁推動全年成長

AI伺服器需求強勁，預期：

- 3Q26 AI機櫃出貨QoQ成長 **高雙位數**
- 3Q26 AI伺服器營收 **季增**
- 2026 AI機櫃出貨 **倍數以上成長**
- 2026 AI多元解決方案並進 **市佔率提升**



鴻海 3+3+3 策略

3
未來產業
+
3
核心技術
+
3
平台賦能

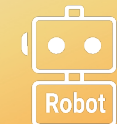
電動車



數位健康



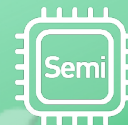
機器人



人工智慧



半導體



新世代通訊



智慧製造



智慧EV



智慧城市



三大未來產業

聚焦可規模化市場，建立下一階段成長動能



電動車

- 海內外市場拓展：
 - MODEL B：預計紐澳年底交車
 - CAVIRA：台灣市場7月開始交車
 - MODEL T：橋頭廠Q2投產
 - 與波蘭國有EMP推動落地歐洲



數位健康

- 場域落地：
導入醫療自動化設備與協作機器人，
優化醫院流程。
- 平台整合：
整合 AI Agent、次世代 HIS、醫療
設備與數位學生。
- 全球商用：
以醫療級製造與CDMS能力服務全球
客戶。

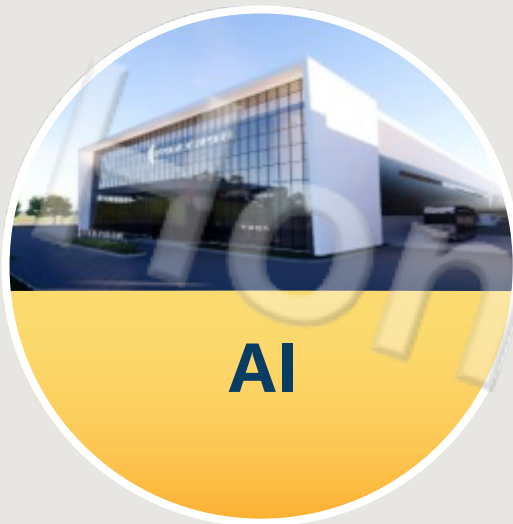


機器人

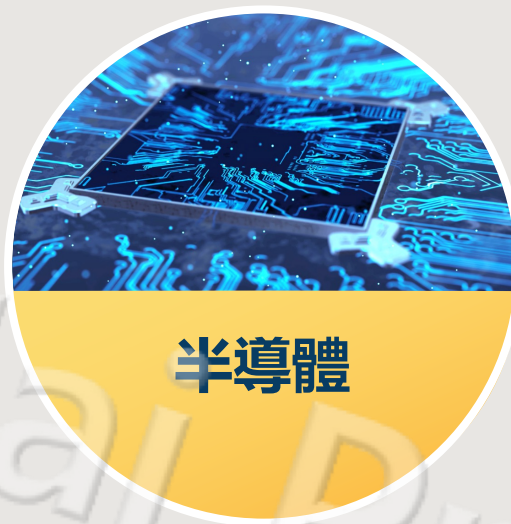
- 場域落地：
以集團製造場域驗證人形與協作
機器人應用。
- 能力整合：
整合AI、數位學生與關鍵模組。
- 規模部署：
推動平台化、量產化與全球導入。

三大核心技術

強化關鍵自主技術，提高產品附加價值



- **AIDC基礎設施：**
攜手Intel、Schneider及SK，整合AI算力、資料中心與能源管理。
- **主權AI平台：**
歐非：攜手Bull/Amini 加速AI落地
亞太：亞灣超算攜手IBM，拓展AI平台
- **自主AI模型：**
FoxBrain優化模型架構與訓練效率，深化在地知識。



- **產能與量產：**
日本8吋廠稼動率逾90%，能見度至Q4。
- **關鍵技術：**
聚焦SiC、車用MCU及AI電源晶片，加速認證與量產
- **全球佈局：**
拓展設計服務與歐洲封測，完善區域布局。



- **衛星部署：**
第二代低軌衛星成功部署，驗證太空通訊能力。
- **全方位製造服務：**
提供地面設備至衛星本體的全方位製造服務。

三大智慧平台進展

成為全球領先的AI平台供應商，以軟硬整合驅動跨產業智慧化生態



智慧製造

- 平台驗證：
Genesis支援AI Agent快速部署。
- 跨廠複製：
建立可跨場域導入的AI製造標準。



智慧電動車

- 量產落地：
電子電氣架構進入整合測試與量產準備。
- 平台進化：
以AI與數據閉環加速智慧車迭代。



智慧城市

- 標竿落地：
CityGPT驗證AI城市治理模式。
- 海外拓展：
推動智慧城市方案跨市場複製。

4 近期重大事件

近期重大事件 | 最新營運進展

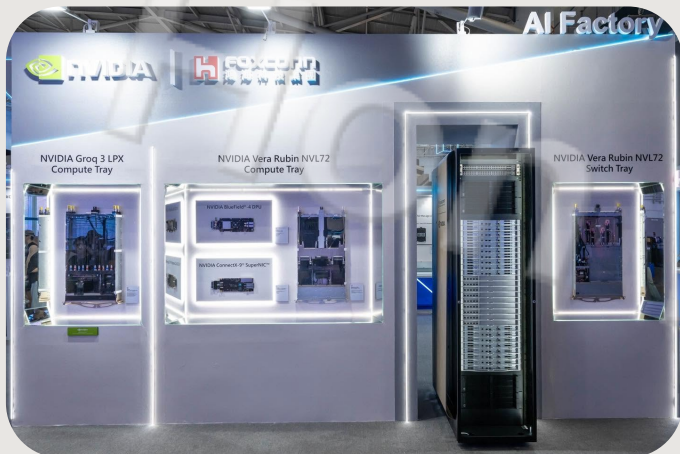


鴻海股東常會通過 1,009 億元現金股利
每股配發 7.2 元

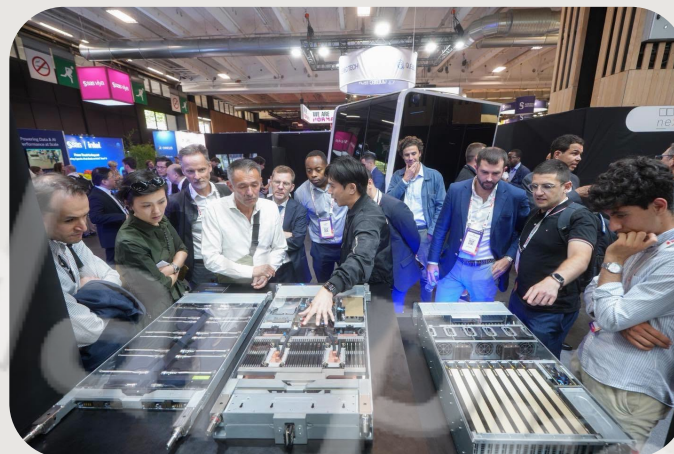


鴻海、Radiall 與 Thales 成立 Tessalia
合資公司，布局歐洲電子零組件生產

近期重大事件 | 近期參展



**COMPUTEX 2026,
展示 NVIDIA VR NVL72、CPO
與三大平台應用**



**首度參展法國 VivaTech 2026
深化歐洲 EV/AI 生態系布局**



**首度參與日本臺灣形象展
展示 MODEL A、MODEL B
與 AI 模組化資料中心**

近期重大事件 | 鴻海研究院

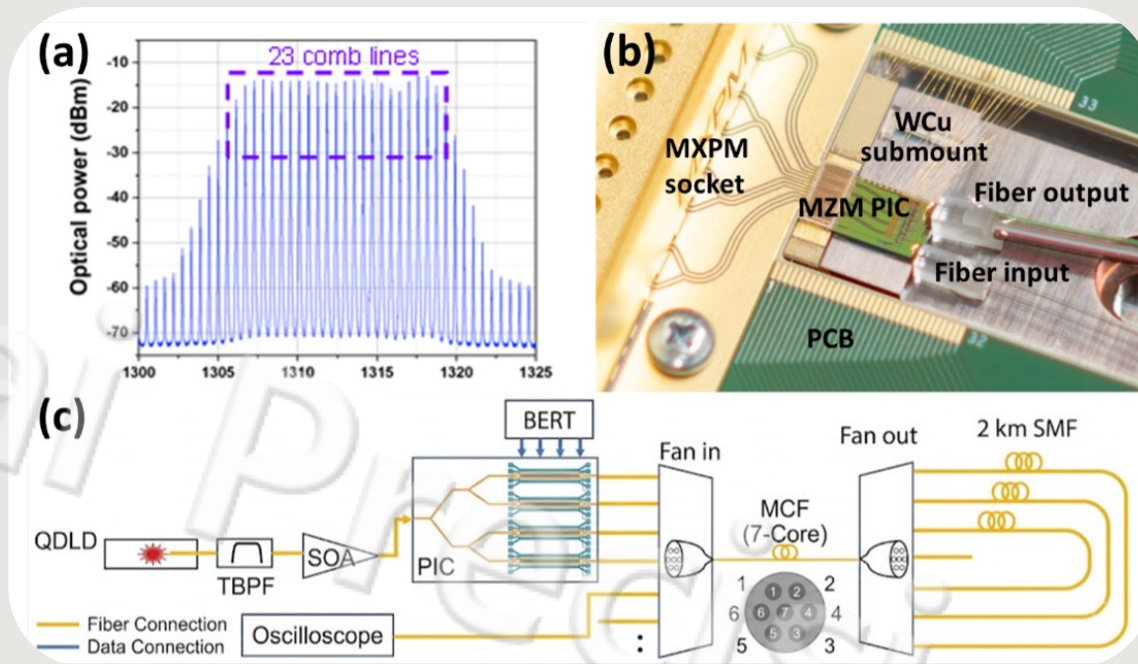


2026年 論文發表

會議論文 **48** 篇

期刊論文 **48** 篇

專利 **16** 件



鴻海研究院攜手陽明交大
研發 34.132 Tbit/s 超大容量矽光子技術

近期重大事件 | 近期獲獎



Hon Hai Precision Industry Co.

Most Honored Company

2026 Asia Executive Team



榮獲《Extel》2026 年
最受尊崇企業及七項大獎



The Fortune Global 500

近期重大事件 | 近期獲獎



最強女力出爐！鴻海楊秋瑾入選
《Fortune》全球最具影響力商界女性



鴻海人資長夏國安榮獲
《HR Asia》年度最佳人資長



鴻海美國人資總監 Winnie Tu
榮獲 Manufacturing Institute
STEP Awards



鴻海董事張慶瑞教授
榮獲亞洲磁性聯合協會
AUMS Award



鴻海研究院洪瑜亨博士
榮獲「優秀青年工程師獎」

近期重大事件 | ESG



與博楓合作：
建立越南可再生能源夥伴關係

舉辦河內綠色能源論壇：
構築越南綠色供應鏈韌性



2026 鴻海科技獎：
逾 200 件海內外作品競逐榮耀

越南 MC Contest 2026 選拔：
培養內部主持人才



全球廠區員工與家庭活動：
斯洛伐克：志工週、夏日家庭日

捷克：科技日

內湖：家庭日



鴻海擴大全球第三方稽核：
累計完成 85 場 RBA VAP，
共獲 6 張鉑金級認證

發布供應商責任報告書：
攜手供應鏈夥伴推動永續發展

歡迎蒞臨：鴻海科技日！



HHTD 26

Accelerating Intelligence

▼ 時間

10月30日(五) 限定受邀賓客

10月31日(六) 開放一般大眾

▼ 地點

台北南港展覽館一館

一樓與四樓

Accelerating Intelligence

2026 鴻海科技日

4F 科技館

活動日期 | 2026 年 10 月 30 - 31 日

活動地點 | 台北南港展覽館 1 館 4 樓

七大展區



Token
Factory



機器人



電動車



半導體



數位健康



三大平台



研究院



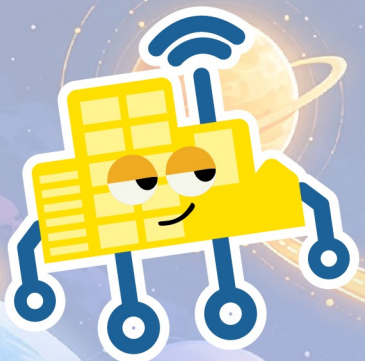
✦ 首度打造 ✦



HHTO 26 1F 親子館

10/31(六) 鴻海將帶來 五大展區、超過 10 種職業體驗！

智慧城市守護者



未來移動



智慧工廠



未來科技探索營



永續行動基地



活動地點

台北南港展覽館 1 館 1 樓

開啟下一代對AI的未來想像！

5 問答時間

提問說明

1. 請點選「舉手」(圖示1)。



2. 主持人點名後，我們會直接取消您的靜音，請您直接提問即可。

3. 請每一位提問者把握一次的發言機會，完整陳述至多兩個提問。

4. 提問結束後，請點選「放下手」(圖示2)。



AI 供應鏈 L1 至 L12 垂直整合，優化成本結構

L1-L3

QD



High Speed Cable



Power Busbar



Sockets & Connectors



L5

Cabinet & Enclosure



Chassis



Heatsink (Air/Liquid)



L6

PCB+PCBA



Fan



L10

Compute Tray

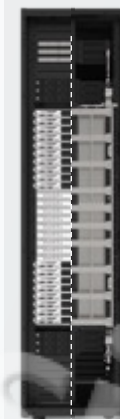


Switch Tray



L11

Rack

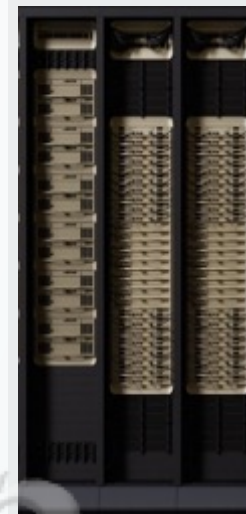


Manifold

Front / Rear

L12

Superpod





分享



合作



共榮

$3+3+3=\infty$